3月11日(火)

時間	A会場（E館5階506）	B会場（E館5階508）	C会場（E館6階606）	D会場（E館6階608）
	配線板とその製造技術	**インテリジェント実装設計技術1**	**高速高周波・電磁特性・回路技術1**	
9:30	11A1-1 (0165) 依頼講演 次世代製造プロセスに対応する投影露光装置の現状と課題 高橋遼太郎 (ウシオ電機)	11B1-1 (0055) 機械学習を用いた建設機械査定システムの開発 佐々木花彩 (群馬大学)	11C1-1 (0062) シリコンフォトニック結晶を用いた漏洩アンテナの指向性の検討 大久保拓海 (拓殖大学)	
9:45		11B1-2 (0132) A Study on Cyclical Learning Rates in Reinforcement Learning and its Application to Temperature and Power Consumption Control of WANGJINGCHEN (群馬大学)	11C1-2 (0052) サブテラヘルツ帯対応金属フォトニック結晶導波路の製作上懸念事項とその検証 金本昇久 (拓殖大学/I-PEX)	
10:00	11A1-2 (0049) プリント配線板における熱的絶縁破壊現象の調査 岸文人 (日産自動車)	11B1-3 (0083) 鏡面加工された製品の外観検査とGANを用いた欠陥画像生成 于沐平 (群馬大学)	11C1-3 (0011) フローティングメタルの形状変化による28GHz帯単方向指向性スロットアンテナの特性向上に関する研究 中島健太 (九州大学)	
10:15	11A1-3 (0074) Niフリー無電解Auめっきによる高周波特性の効果検証 戸田光昭 (メイコー)	11B1-4 (0070) 画像認識を用いた交通誘導ロボットの開発 松木剛博 (群馬大学)	11C1-4 (0119) キャパシタを装荷したスロット線路共振器を用いたダイプレクサの検討 飯田勝栄 (電気通信大学)	**【チュートリアル講演】1**
10:30	11A1-4 (0081) 高いリンス性と濡れ性を有するTGVガラスのめっき前洗浄剤の開発 西座弘明 (パーカーコーポレーションテクニカルセンター)	11B1-5 (0063) デジタル制御DCDCコンバータにおけるAIを用いた異常検知 青山颯 (群馬大学)	11C1-5 (0082) DSPSL構造のモデル化の検討 松浦一聡 (電気通信大学)	司会：八甫谷 明彦 （よこはま高度実装技術コンソーシアム） 11D1-1 (0005) 電子回路実装技術の役割、人材と将来 羽深等 (横浜国立大学大学院)
10:45	**15分休憩** 10:45～11:00			
	信頼性解析技術	**インテリジェント実装設計技術2**	**高速高周波・電磁特性・回路技術2**	
11:00	11A2-1 (0018) 光学式デジタル画像相関法による熱変形挙動解析 宮田和弥 (JFEテクノリサーチ)	11B2-1 (0096) デジタルツインの構築技術と物流システムにおける群制御への適用の検討 呉卓良 (群馬大学)	11C2-1 (0034) GCPW上に配置した非磁性NSSにおける損失のシートインピーダンス依存性 鎌野瑛斗 (東北大学)	11D1-2(0014) 変化し続けるプリント配線板、ガラスコアサブストレート 八甫谷明彦 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)
11:15	11A2-2 (0115) 電子基板へのストレス付与における歪み分布の可視化 中谷洋介 (デンソー)	11B2-2 (0079) Ultra Wide Band測位システムによる位置推定と物流への応用 井上采郁 (群馬大学)	11C2-2 (0121) 平行結合線路と結合線路装荷形スタブを組み合わせた多極型BPFの一検討 林田菜央 (電気通信大学)	
11:30	11A2-3 (0124) 高信頼性アンダーフィル材開発のための内部ひずみに着目した寿命解析手法 吉田拓弥 (ナミックス)	11B2-3 (0142) 赤外線カメラ画像における動物推定根拠に関する研究 力丸彩奈 (長野工業高等専門学校)	11C2-3 (0108) 片方のカットオフ周波数のみを調整可能な広帯域チューナブルフィルタの設計に関する検討 松木淳一郎 (電気通信大学)	
11:45	11A2-4 (0127) ダイアタッチはんだ接合の非破壊X線回折方位顕微鏡法 林雄二郎 (理化学研究所)	11B2-4 (0117) はんだ印刷工程における基板表面凸部を考慮した品質予測技術 永野里奈 (東芝)	11C2-4 (0092) バラクタダイオードを装荷したスロット線路共振器を用いたチューナブルBPFの検討 竹島大樹 (電気通信大学)	
12:00	**昼食** 12:00～13:00　(60分)			
	材料技術＆環境調和型実装技術1	**マイクロメカトロニクス実装技術1**	**高速高周波・電磁特性・回路技術3**	**【チュートリアル講演】2**
13:00	11A3-1 (0148) 依頼講演 ナノカーボン材料の社会実装 石関圭輔 (カーボンフライ)	11B3-1 (0161) 依頼講演 光-無線シームレスネットワークに向けた光電変換デバイス集積・実装 多喜川良 (九州大学)	11C3-1 (0089) バイアスTを用いたバラクタダイオードの簡易的な測定手法に関する検討 塩竹明人 (電気通信大学)	司会:宮代 文夫 （よこはま高度実装技術コンソーシアム） 11D2-1 (0044) 電子機器の高機能化、応用拡大で、半導体・配線板構造が変わる！ － 電子機器実装の狙うべき方向を探る － 本多進 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)
13:15			11C3-2 (0094) 順方向のみが測定可能なVNAのための2ポート校正式を導くもう一つの考え方 松浦弘樹 (電気通信大学)	
13:30	11A3-2 (0133) エポキシ樹脂の構造による銀ミクロフィラー焼結温度への影響 福島孝典 (群馬大学)	11B3-2 (0107) マルチバイタルセンシングのためのE-スポンジの開発 佐藤優 (東京大学)	11C3-3 (0058) 2.4GHz帯電波干渉検知システムの複素量評価に関する検討その1 増井彩弓 (大阪工業大学)	
13:45	11A3-3 (0135) 低温実装用導電性接着剤の開発に向けた樹脂バインダ中でのスズ粒子の焼結誘導 井上雅博 (群馬大学)	11B3-3 (0114) コルゲート加工・転写による縦波型ストレッチャブル配線の形成 伊藤恭平 (東京大学)	11C3-4 (0056) 2.4GHz帯電波干渉検知システムの複素量評価に関する検討その2 川上雅士 (大阪工業大学)	11D2-2 (0041) Society5.0時代のセンサ～IoTから人間拡張まで～ 谷本琢磨 （ＡＫＫＯＤｉＳコンサルティング）
14:00	**15分休憩** 14:00～14:15			
	材料技術＆環境調和型実装技術2	**マイクロメカトロニクス実装技術2**	**高速高周波・電磁特性・回路技術4**	
14:15	11A4-1 (0125) 低温焼成に向けた原子拡散強化銅ナノ粒子 米澤徹 (北海道大学)	11B4-1 (0076) ナノインプリント用Niモールドを用いたダイヤモンド表面のマイクロ加工 松前貴司 (産業技術総合研究所)	11C4-1 (0015) Analysis of Power Transmission Efficiency in S-CPT (Shielded-Capacitive Power Transfer) Systems with Different Electrode Shapes 陳昊 (九州大学)	
14:30	11A4-2 (0103) 銅ナノワイヤから作製した銅不織布の機械的特性と電気化学的特性 薦田康夫 (三井金属鉱業)	11B4-2 (0123) シリコン製ベーパーチャンバーの作製 柳澤直輝 (東京理科大学)	11C4-2 (0090) 小型プリント配線コイルを用いた無線電力伝送回路の遺伝的アルゴリズムによる設計 髙橋文博 (拓殖大学)	**15分休憩** 14:30～14:45
14:45	11A4-3 (0126) フェノール系バインダを用いた銅系導電性ペーストの電気伝導特性および信頼性に及ぼすサブミクロンフィラー添加の効果 内田歩海 (群馬大学)	11B4-3 (0093) Au薄膜転写により平滑化したAlNセラミック基板の表面活性化常温接合 後藤慎太郎 (東北大学)	11C4-3 (0139) 機械学習を利用したトロイダル型インダクタの交流損失推定に関する一検討 室賀翔 (東北大学)	**【チュートリアル講演】3** 司会:本多 進 （よこはま高度実装技術コンソーシアム） 11D3-1 (0038) 光電子集積化の動向と課題 竹村浩一 (アイオーコア)
15:00	11A4-4 (0118) パワーモジュール用樹脂絶縁基板におけるCu／樹脂界面の接合信頼性向上 志村実優 (三菱マテリアル)	**15分休憩** 15:00～15:15 **マイクロメカトロニクス実装技術3**	11C4-4 (0048) ケーブルが接続されたプリント回路基板からの放射エミッションの共振周波数の電磁界シミュレーションによる分析 菊地秀雄 (群馬大学)	
15:15	**15分休憩** 15:15～15:30 **材料技術＆環境調和型実装技術3**	11B5-1 (0129) ALD酸化アルミ薄膜の表面活性化常温接合におけるAr高速原子ビーム照射影響の調査 宇野賢治 (九州大学)	**15分休憩** 15:15～15:30 **高速高周波・電磁特性・回路技術5**	
15:30	11A5-1 (0072) マンガンドープ酸化インジウムスズ薄膜の湿式製膜と電気特性 柏木行康 (大阪産業技術研究所)	11B5-2 (0109) LiNbO3ウェハの表面活性化常温接合における結晶方位依存性の検討 加藤田義樹 (九州大学)	11C5-1 (0008) ダイレクトパターニング技術を用いてフレキシブル基板上に形成した平面回路の準ミリ波帯における特性評価 君川涼真 (九州大学)	11D3-2 (0010) SiCはパワーデバイス主要基板としての地位を確立したか? 宮代文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)
15:45	11A5-2 (0140) 積層造形されたCuCr合金の熱特性評価 保田雄亮 (日立製作所)	11B5-3 (0050) 活性銅原子層を介したシリコンチップと銅基板の常温固相接合 山内峻平 (九州大学)	11C5-2 (0012) コッククロフトウォルトン回路による高周波エネルギーハーベスティング回路の開発とBluetoothモジュール駆動実験 田中颯人 (九州大学)	
16:00	11A5-3 (0037) ナノインデンテーションを用いたSn-Bi-Zn合金の変形挙動評価 川上夏輝 (大阪大学)		11C5-3 (0141) CNTの絶縁処理による超軽量電波吸収体の導電性制御 室賀翔 (東北大学)	
16:15			11C5-4 (0039) 磁気回路解析を用いた磁性ノイズ抑制シートの磁気損失推定に関する一検討 神谷康友 (東北大学)	
16:30				

3月12日(水)

時間	A会場（E館5階506）	B会場（E館5階508）	C会場（E館6階606）	D会場（E館6階608）
	高速高周波・電磁特性・回路技術6	**電子部品・実装技術1**	**MES2024　受賞講演1**	**企業プレゼンテーション1**
9:30	12A1-1 (0078) ライフジャケットのためのデュアルバンド小型・薄型アンテナの検討 佐々木由紀 (東京工芸大学)	12B1-1 (0147) 依頼講演 MEMS技術を用いて製作したシリコンベイパーチャンバーとマイクロ発電システム 内木場 文男 (日本大学)	【MES2024受賞説明】 12C1-1 (0150) 低温Cu-Sn遷移的液相拡散接合のためのSn-Bi合金活用法の検討 黒沢憲吾 (秋田県産業技術センター)	12D1-1 (0007) キーサイトEDAフォトニックIC設計ソリューションの紹介 キーサイト・テクノロジー:梅川光晴
9:45	12A1-2 (0077) 豚を対象とするワイヤレスボディエリアネットワークのための電磁界解析モデルの簡易化の検討 中山真衣 (東京工芸大学)			12D1-2 (0137) CR-8000 Design Force　３次元実装を支援するチップレット・先端半導体パッケージ・システム協調設計環境 図研:藤田陽子
10:00	12A1-3 (0097) スパイラルコイルを利用した生体内外間通信における生体内コイルの傾きに対する伝送特性の検討 富田有美 (東京工芸大学)	12B1-2 (0046) 酢酸による金属塩被膜処理したSn-Znはんだ付における接合温度の影響 山﨑浩次 (群馬大学)	12C1-2 (0151) 高密着銅めっき回路形成技術のフィルムやガラス基板への応用 川上雄介 (ニコン)	12D1-3 (0013) メッキや部品不良解析に有効な蛍光X線・グロー放電を用いたHORIBAの分析装置のご紹介 堀場製作所:谷洋平
10:15	12A1-4 (0098) 給電部をガラス基板端部に有する透明広帯域ダイポールアンテナの検討 筒浦希望 (東京工芸大学)	12B1-3 (0064) マスターカーブに基づくAgナノ粒子の加圧焼結接合における焼結性の可視化 碓井脩斗 (東芝)	12C1-3 (0152) Siダイ/アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度におよぼす球状シリカフィラー添加量および粒度分布の影響 苅谷義治 (芝浦工業大学)代理	12D1-4 (0033) 温度・湿度変化下における膨張、粘弾性の測定装置と測定事例 ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン:大塚康城
10:30	12A1-5 (0110) ITO透明導電膜で形成するミリ波帯対応半円不平衡ダイポールアンテナの検討 鈴木拓海 (東京工芸大学)	12B1-4 (0144) 熱膨張係数分布を有する基板を用いた集積デバイス実装の検討 佐藤峻 (産業技術総合研究所)	**15分休憩** 10:35～10:50	12D1-5 (0069) 電子部品・電子基板解析サービスのご紹介 先端力学シミュレーション研究所:近藤治
10:45	**15分休憩** 10:45～11:00		**MES2024　受賞講演2** 12C2-1 (0157) ハイブリット接合における洗浄プロセスとCuパッドリセスの関係 小池美夏 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)	**15分休憩** 10:45～11:00
	高速高周波・電磁特性・回路技術7	**電子部品・実装技術2**		**企業プレゼンテーション2**
11:00	12A2-1 (0130) プリント配線板の平行平板共振を励起する信号配線を対象とした種々シミュレータによる伝送特性比較 田中顕裕 (RITAエレクトロニクス/岡山大学)	12A2-1 (0020) エポキシ樹脂成形品における工程起因の反り予測技術の開発 大村紘司 (デンソー)		12D2-1 (0075) 高熱伝導グラファイト複合型高性能ヒートスプレッダーのご紹介 サーモグラフィティクス:小西大介
11:15	12A2-2 (0084) 広帯域透過型電磁メタサーフェスの単位構造設計 Yuxiang QIU (東京大学)	12A2-2 (0067) Au薄膜を用いた原子拡散接合法による表面粗さが大きな基板の接合性能の向上 野口皓介 (東北大学)	12C2-2 (0153) 放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による３次元熱伝達解析 荒尾修 (デンソー)	12D2-2 (0080) 化合物データベースを用いた有望な材料・特許探索 日立ハイテク:柘植悠太
11:30	12A2-3 (0029) ミリ波帯における伝送線路の銅箔の表面粗さにGroisseモデルを適用した解析と実測結果の比較 服部元磨 (マイクロウェーブファクトリー)	12A2-3 (0068) Ti薄膜を用いた原子拡散接合法における接合強度の膜厚依存性 瀧伸哉 (東北大学)		
11:45	12A2-4 (0112) ミリ波帯での材料の周波数依存性による配線板の伝送損失への影響 安陪光紀 (NTTデバイスクロステクノロジ)	12A2-4 (0100) ハイブリッドシートヒーターの開発 堤慎太郎 (フジクラ)		
12:00	12A2-5 (0045) 5Gミリ波帯において高い伝送減衰率Rtpを有するグラフェンノイズ抑制シート 渡邉雅人 (電磁材料研究所)			

12:15　昼食/ポスターセッション・企業展示　コアタイム　12:15～14:00　(105分)

12P3　ポスターセッション
E館5階507　9所属

12P3-1	0016	日立製作所	岩崎富生
12P3-2	0027	日本山村硝子	池田拓朗
12P3-3	0031	日東紡績	西久保椋
12P3-4	0138	日鉄ケミカル＆マテリアル	王宏遠
12P3-5	0022	シミズ	丸田博之
12P3-6	0025	メイコー	神山孝一
12P3-7	0105	東北大学	小関奨吾
12P3-8	0120	東北大学	菱沼景
12P3-9	0057	ウシオ電機	Kejun Wu

12Q3　企業展示コアタイム
E館6階601～605・607　展示企業22社

607	12Q3-1	㈱構造計画研究所
	12Q3-2	奥野製薬工業㈱
	12Q3-3	ウシオ電機㈱
	12Q3-4	キーサイト・テクノロジー㈱
	12Q3-5	タカヤ㈱
	12Q3-23	レーザーテック㈱
601	12Q3-6	㈱堀場製作所
	12Q3-7	丸文㈱
	12Q3-8	オムロン㈱
	12Q3-9	マイクロウェーブファクトリー㈱
602	12Q3-11	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱
	12Q3-12	I-PEX㈱
	12Q3-13	日産化学㈱
603	12Q3-14	㈱三ツワフロンテック
	12Q3-15	㈱先端力学シミュレーション研究所
	12Q3-16	サカタインクス㈱
604	12Q3-17	㈱サーモグラフィティクス
	12Q3-18	㈱日立ハイテク
	12Q3-19	㈱図研
605	12Q3-20	日本高純度化学㈱
	12Q3-21	HPCシステムズ㈱
	12Q3-22	電子科学㈱

14:00　表彰式　14:00～14:30　E館1階 講堂（A・B会場サテライト　予定）
MES2024受賞　ベストペーパー賞：5件、研究奨励賞：5件、ポスターアワード：2件

BP	ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	小池 美夏 氏
	秋田県産業技術センター	黒沢 憲吾 氏
	芝浦工業大学大学院	田中 宏樹 氏
	㈱デンソー	荒尾 修 氏
	㈱ニコン	川上 雄介 氏
YA	ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	山野 友梨子 氏
	大阪大学	福永 崇平 氏
	大阪大学大学院	平林 湧 氏
	大阪大学大学院	川上 夏輝 氏
	山形大学大学院	奈良 健汰 氏
PA	関西大学	中筋 渉 氏
	東北大学	後藤 慎太郎 氏

14:30　15分休憩　14:30～14:45

14:45　12R4-1 (0159) 14:45～15:45 (60分)　E館1階 講堂（A・B会場サテライト　予定）
特別講演　1
「緊迫化する中台関係と日本外交」
拓殖大学 政経学部 教授　丹羽 文生 氏

15:45　15分休憩　15:45～16:00

16:00　12R4-2 (0160) 16:00～17:00 (60分)　E館1階 講堂（A・B会場サテライト　予定）
特別講演　2
「Empowering AI Innovation with Versatile and Open-source RISC-V Processor」
Tenstorrent Inc, RISC-V Architect Gr　Fellow　石井 康雄 氏
Tenstorrent Japan KK　Country Manager,Japan　中野 守 氏

17:00　移動・交流会受付　17:00～17:30 (30分)

17:30　交流会　B館地下1階食堂
17:30～19:00
(事前申し込みが必要です)

19:00

3月13日(木)

時間	A会場（E館5階506）	B会場（E館5階508）	C会場（E館6階606）	D会場（E館6階608）
9:30				
	最先端めっき実装技術1	**サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装1**	**3D・チップレット技術1**	**カーエレクトロニクス実装**
9:45	13A1-1 (0149) 依頼講演 ナノポーラスCuめっきを利用した次世代Cu-Cu接合技術 片瀬琢磨 (三菱マテリアル)	13B1-1 (0017) Cauer型熱回路網に基づくマイクロプロセッサの非定常熱モデルに関する検討 西剛伺 (足利大学)	13C1-1 (0059) TSVのCuビアに低熱膨張係数材料を添加した複合材料を用いた熱応力低減に向けたシミュレーション解析 岡本虹太朗 (熊本大学)	13D1-1 (0146) 依頼講演 半導体パッケージの動向と車載向けパッケージの課題 西田秀行 (NEP Tech. S&S, ニシダエレクトロニクス実装技術支援)
10:00		13B1-2 (0042) トポロジー最適化の自然空冷ヒートシンクへの適用検討 浅井勇吾 (パナソニックインダストリー)	13C1-2 (0131) TSV形成のためのエッチングプロセスにおけるスカロップ低減と形状改善に向けたプロセス開発 園田康太郎 (熊本大学)	
10:15	13A1-2 (0035) 多孔質銅めっき皮膜を用いたセラミック基板に対するクラックの改善 中川穂乃佳 (奥野製薬工業)	13B1-3 (0087) 高密度垂直配向カーボンナノチューブの熱伝導率 渡辺倭 (静岡大学)	13C1-3 (0111) 次世代半導体に向けたレーザー転写技術による極薄Siチップのハンドリング 根本俊介 (神奈川県立産業技術総合研究所)	13D1-2 (0003) 車載用廃蓄電池のリユースと太陽光発電による完全オフグリッド型電力供給システム 下位法弘 (東北工業大学)
10:30	13A1-3 (0040) ガラス基板への密着性と信頼性を有するめっきプライマーの検討 中辻達也 (イオックス)		13C1-4 (0136) Via-last TSVを用いたシャトルチップ3D-IC化のためのテンポラリー接着技術 冨永晃洋 (東北大学)	13D1-3 (0030) SMD型・NSMD型BGAはんだ接合部における温度サイクルによる疲労き裂進展の近似式評価 奥園倫太郎 (横浜国立大学)
10:45	**15分休憩** 10:45～11:00			13D1-4 (0106) Ag拡散接合を用いた10μmピッチCuピラーの低温・低荷重・短時間接合技術 桂章皓 (大阪大学産業科学研究所)
	最先端めっき実装技術2	**サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装2**	**3D・チップレット技術2**	
11:00	13A2-1 (0101) 有底孔に対する電気銅めっきにおけるチオ尿素の電気化学的挙動の考察 岡本尚樹 (大阪公立大学)	13B2-1 (0032) ポーラス金属の構造制御による熱伝導率の向上と熱交換器への応用 小林亮平 (住友電気工業)	13C2-1 (0143) Cu配置設計起因のエロージョンが支配するハイブリッド接合歩留り強化 福島誉史 (東北大学)	**15分休憩** 11:00～11:15 **ヘルスケア・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス**
11:15	13A2-2 (0102) 次世代半導体パッケージ基板における小径ビア形成技術の開発 山岸はるか (新光電気工業)	13B2-2 (0088) 高密度CNTフォレストによるTIM開発 奥村友貴 (静岡大学)	13C2-2 (0054) 自己ナノ粒子化を利用したCu-Cuハイブリッド接合技術の研究 川島凌太朗 (東北大学)	13D2-1 (0156) 依頼講演 まちづくりとエレクトロニクスデバイス 依田光正 (日本大学)
11:30	13A2-3 (0023) 高電流密度における硫酸銅めっき用添加剤について 岡田将太郎 (JCU)	13B2-3 (0060) パワーモジュールの熱抵抗と伝熱面積を用いた近似評価に関する研究 門脇亘大 (横浜国立大学)	13C2-3 (0134) 自己組織化実装を用いたハイブリッド接合におけるCu-Cu接合性の強化 杜澤華 (東北大学)	
11:45	A会場利用不可		13C2-4 (0116) チップ一括配置を行う新プロセス装置の開発 毛受利彰 (リンテック)	13D2-2 (0155) 依頼講演 ヘルスケアおよびスポーツ応用に向けた超薄膜エレクトロニクスの開発 山岸健人 (東京大学)
12:00			13C2-5 (0154) 熱インプリントによる10μmピッチ先鋭マイクロバンプ形成技術の開発 田中勇登 (パナソニック ホールディングス)	
12:15		**昼食/ポスターセッション・企業展示　コアタイム** 12:15～13:30　(75分) **13P3** **ポスターセッション　E館5階507**　ポスター展示：9所属 **※12日　12P3・12Q3　同様** **企業展示コアタイム　E館6階601～605・607**　展示企業：22社		
	スマートプロセス学会	**サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装3**	**部品内蔵・検査技術**	**光回路実装技術1**
13:30	第24回 有機/無機接合研究委員会講演 司会:井上雅博 (群馬大学) 13A4-1 半導体後工程向け低誘電・高柔軟・感光性ポリイミド組成物の開発 山口貴史 (荒川化学工業)	13B4-1 (0051) 埋込性に優れた熱伝導性樹脂フィルム基板材の開発 徳久憲司 (古河電気工業)	13C4-1 (0145) 依頼講演 民生部品・技術を活用した小型人工衛星打上げロケット用電子機器の開発 竹政哲 (インターステラテクノロジズ)	13D4-1 (0021) マルチモード光電集積CPOモジュール技術 山本崇 (京セラ)
13:40				
13:45		13B4-2 (0061) 半導体チップ放熱における放熱樹脂基板の効果検証 戸田光昭 (メイコー)		13D4-2 (0113) Co-Packaged Optics向け超小型106Gb/s ×8チャンネルリニアドライブVCSELトランシーバ 吉田航 (古河電気工業)
14:00		13B4-3 (0073) 半導体チップ放熱における放熱樹脂を用いた部品内蔵基板の効果検証 戸田光昭 (メイコー)	13C4-2 (0158) 依頼講演 部品内蔵基板と半導体パッケージング工程へのシステム設計アプローチ 松澤浩彦 (図研)	13D4-3 (0085) 高密度電気プラガブルインターフェースを用いた50Gbaud × 16ch VCSELトランシーバ用評価ステーション 米山翔 (古河電気工業)
14:15	13A4-2 量産実績を持つ OKI独自の異種材料接合技術 CFBとその未来への展望 鈴木貴人 (沖電気工業)	13B4-4 (0104) SiC-MOSFETパワーモジュールのパワーサイクル試験におけるゲート電圧正負切替の影響 安藤拓司 (産業技術総合研究所)		13D4-4 (0066) Co-Packaged Optics向け+22dBm×8チャンネルブラインドメイト型外部光源 白石勇希 (古河電気工業)
14:30		**15分休憩** 14:30～14:45 **サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装4**	13C4-3 (0086) バウンダリスキャンによる待機状態ICの配線検査を制御するMCUプログラムの生成 土井翔平 (徳島大学)	**15分休憩** 14:30～14:45 **光回路実装技術2**
14:45		13B5-1 (0099) 新規Bi系高温鉛フリー板状はんだの接合強度と熱抵抗評価 安藤拓司 (産業技術総合研究所)	13C4-4 (0053) 超微細バンプの計測を可能とする三次元センサの開発 水野佑樹 (東光高岳)	13D5-1（0164） 光回路実装技術 依頼講演 異種材料薄膜転写がもたらす光集積回路の高性能化 高 磊（産業技術総合研究所）
15:00	**10分休憩** 15:00～15:10 **スマートプロセス学会**	13B5-2 (0122) 半導体封止材料の吸湿挙動解析手法の開発 山口翔 (東芝)		
15:15	第24回 有機/無機接合研究委員会講演 司会:木村 文信 (東京大学) 13A5-1 炭素繊維強化プラスチックとシラン処理アルミニウム合金の熱圧接合強度に及ぼす熱条件の影響 李蔚豪 (大阪大学)	13B5-3 (0036) 高破壊靭性のAlN基板を用いた温度サイクル高信頼性と高放熱性を両立したCu張基板 小舘直人 (U-MAP)		13D5-2 (0091) 回路形成向けUV硬化型透明ドライフィルム材料の開発 田中麻稀 (パナソニックインダストリー)
15:30		13B5-4 (0095) 焼結型銅接合材料の実用化に向けたプロセスの検討 杉政悠香 (三菱マテリアル)		13D5-3 (0128) CWDM光源超小型化のための集光共振器集積導波モード共鳴フィルタの設計 小澤桂介 (京都工芸繊維大学)
15:45				
16:00	13A5-2 大気圧低温プラズマを用いた異種材料間の接着性向上 山﨑顕一 (東芝インフラシステムズ)			
16:15				
16:30				

一般講演：110件
特別講演：2件
依頼講演：11件
MES2024 BP受賞講演：5件
チュートリアル講演：6件
スマプロ有機無機：4件
企業プレゼンテーション：7件　企業:23社（展示:22社）
ポスター：9件